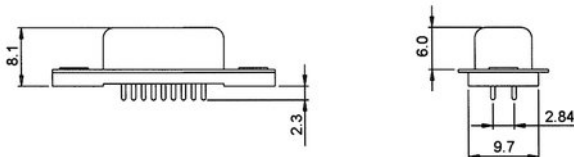
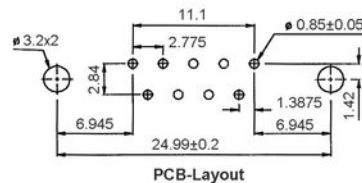
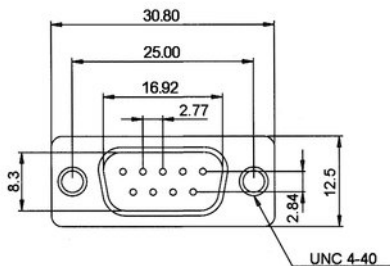
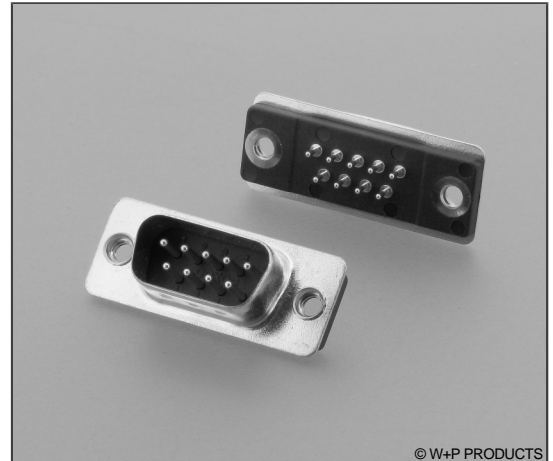


D-Sub Steckverbinder, gerade, Lötstifte – Notebook-Version

D-Sub Connectors, Straight, Solder Pins – Notebook Type

Technische Daten / Technical Data

Gehäuse	Stahl vernickelt, verzinkt
Shell	Steel, tin coated over nickel
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Contact Surface	Gold over nickel
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	1 kV AC
Test Voltage	1 kV AC
Nennstrom	5 A
Current Rating	5 A
Temperaturbereich	-55 °C ... +125 °C
Temperature Range	-55 °C ... +125 °C
Verarbeitung	Wellenlötverfahren
Processing	Wave soldering



Series

425

Contacts

09

09

Terminal

1

1 Stiftkontakte
Male

Quality*

3

GK 1 >500 Steckzyklen
Quality class 1: 500 cycles min.
GK 2 >200 Steckzyklen
Quality class 2: 200 cycles min.
GK 3 >50 Steckzyklen
Quality class 3: 50 cycles min.

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:

